

3月15日暫定プログラム

会場	分野	プログラム No.	開始時間	終了時間	講演選択	発表者	所属	演題名
A	官能検査システム化技術	15A1-1	9:30	10:00	依頼講演	権藤 詩織	産業技術総合研究所	データ駆動型スピニング加工による高精度板厚制御
		15A1-2	10:00	10:15	論文発表	内田 雅人	米子工業高等専門学校	CNNを用いたコーヒー生豆における欠点豆の検知
		15A1-3	10:15	10:30	論文発表	本村 大成	産業技術総合研究所	低温スパッタ成膜用プラズマ源の静電プローブ測定
	信頼性解析技術	15A2-1	10:50	11:05	論文発表	藤原 侑	ソニーセミコンダクタソリューションズ(株)	半導体パッケージの樹脂酸化による信頼性影響
		15A2-2	11:05	11:20	論文発表	林 雄二郎	株式会社豊田中央研究所	放射光X線を用いたパワーモジュール用はんだ接合の非破壊方位マッピング
		15A2-3	11:20	11:35	論文発表	布施 淳也	横浜国立大学	ウエハ接合強度測定におけるばらつき最小化の検討
		15A2-4	11:35	11:50	論文発表	岩田 知也	横浜国立大学	ウエハ接合前後プロセスが接合強度測定に及ぼす影響
	インテリジェント実装設計技術 (1)	15A3-1	13:00	13:15	論文発表	望月 耕輔	群馬大学大学院	モンタージュと機械学習を組み合わせたエアバッグの良否判定手法の開発
		15A3-2	13:15	13:30	論文発表	中島 慧	群馬大学	会話の履歴とジャンルを考慮したチャットボットの応答精度の検討
		15A3-3	13:30	13:45	論文発表	梶塚 祐輝	群馬大学大学院	モデルベース開発手法と強化学習に基づく冷蔵システムの省消費電力制御
		15A3-4	13:45	14:00	論文発表	力丸 彩奈	長野工業高等専門学校	深層学習を用いた動物認識システムにおけるプレトレーニングモデルの検討
	インテリジェント実装設計技術 (2)	15A4-1	14:20	14:35	論文発表	堀口 拓海	東京電機大学大学院	超小型衛星の通信系の開発
		15A4-2	14:35	14:50	論文発表	佐藤 英思	東京電機大学	超小型衛星に搭載する受信用UHFアンテナの開発
		15A4-3	14:50	15:05	論文発表	遠藤 健太	東京電機大学	超小型衛星搭載用姿勢制御アクチュエータの姿勢推定システムの開発
		15A4-4	15:05	15:20	論文発表	佐藤 圭	東京電機大学大学院	超小型衛星における磁気トルカによる姿勢制御へのB-dot制御の適用
	インテリジェント実装設計技術 (3)	15A5-1	15:40	15:55	論文発表	松本 優樹	東京電機大学	最適化手法を用いたMPPT制御
		15A5-2	15:55	16:10	論文発表	高橋 達矢	東京電機大学	超小型衛星用給電システムの開発
		15A5-3	16:10	16:25	論文発表	青山 颯	群馬大学	プローブ先端の外観検査における深層学習のための事前画像処理
		15A5-4	16:25	16:40	論文発表	本田 真吾	株式会社ココ	GANと切り貼り手法を組合せたプローブ先端外観検査用教師データの生成に関する検討
	インテリジェント実装設計技術 (4)	15A6-1	17:00	17:15	論文発表	石 博元	群馬大学大学院	深層学習にもとづくプローブ先端外観検査へのヒートマップの適用と精度向上の検討
15A6-2		17:15	17:30	論文発表	松澤 浩彦	株式会社図研	半導体検査のプローブカード 設計ネット層割当ての最適化アプローチ	
B	ものづくり(1)	15B1-1	9:30	9:45	ものづくり	稲原 順一	エスベック(株)	自動計測システムによる高周波インダクタの温度特性評価効率の向上
		15B1-2	9:45	10:00	ものづくり	伊藤 淳	株式会社クラレバス	プラズママイニングを用いたプラズマ処理効果の評価と従来手法との比較
		15B1-3	10:00	10:15	ものづくり	梅田 英知	東レエンジニアリング(株)	マイクロLEDディスプレイ製造における歩留まり改善に向けた取り組み
		15B1-4	10:15	10:30	ものづくり	伊藤 卓	株式会社カネカ	無電解銅めっきによるメタライズに対応した新規ポリイミドフィルムの開発
	ものづくり(2)	15B2-1	10:50	11:05	ものづくり	山下 智章	(株)レゾナック	セミアディティブ工法対応材料【PF-EL(R)】上への小径ブラインドピアホール形成
		15B2-2	11:05	11:20	ものづくり	長野 暢明	株式会社JCU	プリント基板用硫酸銅めっき向け酸性クリーナー
		15B2-3	11:20	11:35	ものづくり	砂入 允哉	株式会社レゾナック	低弾性率セグメントの導入によるパッケージ基板材料の反り抑制
		15B2-4	11:35	11:50	ものづくり	長谷川清久	株式会社図研	3D-IC/パッケージ/ボード設計向けCADツールの進化と取組み
	材料/環境調和型実装技術 (1)	15B3-1	13:00	13:15	論文発表	千田 拓実	大阪大学大学院	金属架橋型導電性接着剤においてSn-3.0Ag-0.5Cuによる架橋形成が熱伝導性に与える影響
		15B3-2	13:15	13:30	論文発表	小田島大輔	群馬大学	トリエタノール誘導体を表面処理剤の分子構造と銅系導電性ペーストの電気伝導特性発達の関係
		15B3-3	13:30	13:45	論文発表	松浪 由香里	群馬大学	銅系導電性ペーストの環境曝露中の電気的信頼性に及ぼすフィラー表面処理剤の影響
		15B3-4	13:45	14:00	論文発表	井上 雅博	群馬大学	バインダ化学因子に基づくカーボンナノチューブ系導電性ペーストの動的パーコレーション制御
	材料/環境調和型実装技術 (2)	15B4-1	14:20	14:35	論文発表	須賀 唯知	明星大学	Pt触媒を使った硝酸活性化によるCuナノ粒子の焼結挙動
		15B4-2	14:35	14:50	論文発表	小池 大輔	東芝デバイス&ストレージ(株)	半導体ダイアタッチ材(銀シンタリングペースト)における界面電気抵抗測定手法の確立
		15B4-3	14:50	15:05	論文発表	松田 朋己	大阪大学	マイクロ力学試験を用いた焼結銀/シリコン直接接合界面の破壊挙動評価
		15B4-4	15:05	15:20	論文発表	小林 祐輝	新光電気工業(株)	樹脂とシリカフィラーが露出されたコンジット材料表面へのスパッタリングシード形成に関する一考察
	材料/環境調和型実装技術 (3)	15B5-1	15:40	15:55	論文発表	妹尾 駿作	パナソニック環境エンジニアリング(株)	ガラス上の高密着銅めっき皮膜を実現する中間層の開発
		15B5-2	15:55	16:10	論文発表	土屋 政人	宇都宮大学大学院	電解精錬によるスズのリサイクルに関する研究
		15B5-3	16:10	16:25	論文発表	佐藤 誠	東レ(株)	耐湿熱性を大幅に向上させたコンデンサ用蒸着フィルムの開発
		15B5-4	16:25	16:40	論文発表	齊藤 文靖	大阪公立大学	反応性スパッタリングによるTi系およびV系MAX合金薄膜の物性に及ぼすA元素とX元素の効果
15B5-5		16:40	16:55	論文発表	岩崎 富生	株式会社日立製作所	先端分子シミュレーションに基づいたマテリアルズ・インフォマティクスによるサステナブル複合材料の高効率設計技術	
C	部品内蔵技術 (ロードマップ) (1)	15C1-1	9:30	9:45	論文発表	EPADsロードマップ研究会委員	部品内蔵技術委員会 EPADsロードマップ研究会	部品内蔵部品ロードマップ(1)
		15C1-2	9:45	10:00	論文発表	EPADsロードマップ研究会委員	部品内蔵技術委員会 EPADsロードマップ研究会	部品内蔵部品ロードマップ(2)
		15C1-3	10:00	10:15	論文発表	EPADsロードマップ研究会委員	部品内蔵技術委員会 EPADsロードマップ研究会	部品内蔵部品ロードマップ(3)
		15C1-4	10:15	10:30	論文発表	EPADsロードマップ研究会委員	部品内蔵技術委員会 EPADsロードマップ研究会	部品内蔵部品ロードマップ(4)
	部品内蔵技術 (ロードマップ) (2)	15C2-1	10:50	11:05	論文発表	EPADsロードマップ研究会委員	部品内蔵技術委員会 EPADsロードマップ研究会	部品内蔵部品ロードマップ(5)
		15C2-2	11:05	11:20	論文発表	EPADsロードマップ研究会委員	部品内蔵技術委員会 EPADsロードマップ研究会	部品内蔵部品ロードマップ(6)
		15C2-3	11:20	11:35	論文発表	EPADsロードマップ研究会委員	部品内蔵技術委員会 EPADsロードマップ研究会	部品内蔵部品ロードマップ(7)
		15C2-4	11:35	11:50	論文発表	EPADsロードマップ研究会委員	部品内蔵技術委員会 EPADsロードマップ研究会	部品内蔵部品ロードマップ(8)
	部品内蔵/3次元造形(1)	15C3-1	13:00	13:30	依頼講演	森 裕幸	日本アイ・ピー・エム(株)	非対称構造をもつプリント配線板の反り最適化手法の可能性
		15C3-2	13:30	14:00	依頼講演	加藤木一明	(有) ケイ・ピー・ディ	はんだ付不要基板ジョイント導通技術の開発
	部品内蔵/3次元造形(2)	15C4-1	14:20	14:35	論文発表	瀧川 慎二	株式会社FUJI	フルアディティブ工法を応用したエレクトロニクス3Dプリンターの開発
		15C4-2	14:35	14:50	論文発表	中村 和人	名古屋大学	パワー半導体基板内蔵技術によるSiCハーフブリッジ回路の設計・試作・評価
	サーマルマネージメント&パワーエレクトロニクス実装	15C5-1	15:10	15:25	論文発表	本多 眞慧	富山県立大学	熱伝導解析を用いたサーマルビアの直径と熱縮流の関係の評価
		15C5-2	15:25	15:40	論文発表	小西 太一	富山県立大学	SiC MOSFETのホットスポット温度予測手法の検討ードレイン電圧の影響ー
		15C5-3	15:40	15:55	論文発表	臼井 正則	株式会社豊田中央研究所	応力センサによるデバイス実装部の接合欠陥分布の予測(1) 機械学習を利用した応力と温度センサの比較と配置最適化
		15C5-4	15:55	16:10	論文発表	臼井 正則	株式会社豊田中央研究所	応力センサによるデバイス実装部の接合欠陥分布の予測(2) 欠陥分布予測結果の解析
15C5-5		16:10	16:25	論文発表	藤見 幹汰	富山県立大学	低接触圧力領域における接触熱抵抗予測のための接触率算出方法の検討	